

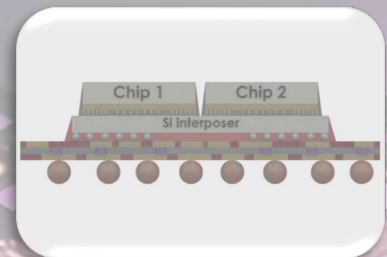
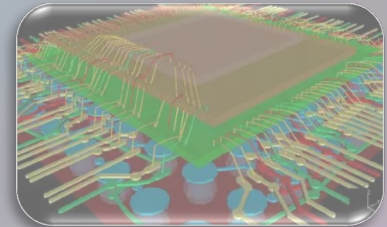
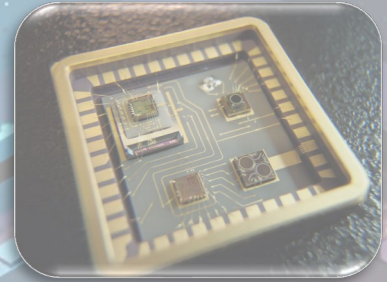
Tecnologías de System in Package

Microcredencial 3 ECTS (20h aula + 10h lab.)

CÁTEDRA UPM – INDRA en MICROELECTRÓNICA


¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

1. Tecnologías de encapsulado emergentes SiP y SoC
2. Ventajas de las tecnologías SiP
3. Retos y limitaciones de las tecnologías SiP
4. Componentes de un SiP: circuitos integrados, componentes pasivos, tecnologías de interconexión
5. Diseño y fabricación de SiPs (técnicas de diseño, ensamblado y encapsulado)
6. Prueba y verificación de SiPs



PRECIO DE LA
MATRÍCULA 100%
GRATUITO. FINANCIADO
POR CÁTEDRA
UPM-INDRA

 28/05/2025 al 16/07/2025 (X y J) de 17:00h a 19:00h

 PRESENCIAL. Laboratorios y aulas de la ETSI Telecomunicación

 comunidad.microelectronica@upm.es

PREINSCRÍBETE